

第8期
株主通信



株式会社テラプローブ



小さな 小さな 大きな未来

現代では小指の先ほどのサイズにまで凝縮された集積回路。
ムーアの法則のままに高集積化とサイズダウンを繰り返し、
私たちの生活を陰から支え続けています。

ごあいさつ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は創業以来、DRAMのウエハテストを中心に半導体のテスト受託を展開してまいりましたが、昨年は、世界的な景気の減速に伴うPCなどの需要減少に加え、歴史的な円高の継続により、主要顧客が経営難に陥るなどとても厳しい一年となりました。

このような厳しい環境下においても、当社は、顧客からの数々の要望に応える中で蓄積した技術やノウハウを、国内外の顧客に積極的に提供し、様々なご要望にお応え出来るよう取り組んでまいりました。

また昨年は、株式会社テラミクロスが製造するウエハレベルパッケージという非常に小さく薄いパッケージと当社の半導体テストを一貫して提供することが出来るようになりました。今後はこの強みを生かし、国内外の顧客に営業活動を強化していく所存です。

さらに、今年度は、新政権により日本経済の立て直しが進むことに加え、主要顧客の経営も安定するなど、当社を取り巻く環境

は改善に向かうものと思われます。このチャンスを確実にとらえられるように、全社をあげて取り組んでまいります。

テラプローブは若い会社ですので、勢いを失わず成長を続け、テストハウスという業態を確実に一般の皆様にも認識していただけるよう努力してまいります。また、事業発展はもちろんのこと、社会への貢献にも、グループ一丸となって積極的に取り組んでまいりますので、引き続きご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長兼CEO

渡辺 雄一郎



財務ハイライト

(2013年3月31日現在)

連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	2012年3月末	2013年3月末
〈資産の部〉		
流動資産合計	10,675	11,022
固定資産合計	30,412	24,519
資産合計	41,088	35,542
〈負債の部〉		
流動負債合計	11,298	7,760
固定負債合計	8,592	5,544
負債合計	19,890	13,304
〈純資産の部〉		
資本金	11,823	11,823
資本準備金	11,380	11,380
株主資本合計	19,645	20,145
純資産合計	21,198	22,237
負債純資産合計	41,088	35,542



自己資本率は56.6%になり、前年度比9.5ポイント増加。

連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	2011年度 (2011年4月1日～2012年3月31日)	2012年度 (2012年4月1日～2013年3月31日)
売上高	24,190	21,306
売上原価	19,393	19,119
売上総利益	4,796	2,187
販売費及び一般管理費	2,086	2,229
営業利益	2,709	△42
営業外収益合計	167	577
営業外費用合計	475	434
経常利益	2,401	101
特別利益合計	1,069	260
特別損失合計	8,195	4
税金等調整前四半期純利益	△4,724	357
法人税等	602	△221
少数株主利益	203	78
当期純利益	△5,530	500



経費削減を行うも、受託数量減により減収減益。ただし、当期純利益はプラス転換へ。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

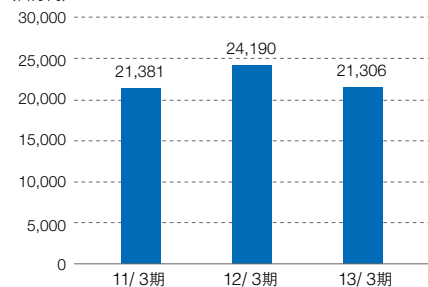
科目	2011年度 (2011年4月1日～2012年3月31日)	2012年度 (2012年4月1日～2013年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,813	7,543
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,671	△2,896
財務活動によるキャッシュ・フロー	△804	△4,260
現金及び現金同等物の増減額(△減少)	△1,663	485
現金及び現金同等物の期末残高	5,557	6,043



残高は6,043百万円になり、前年同期比8.7%増。

売上高

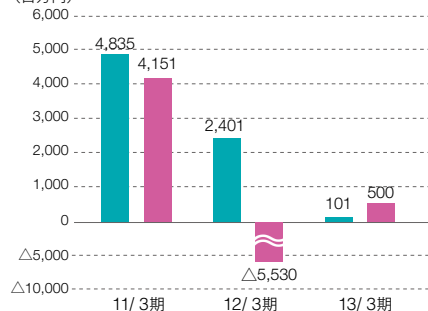
(百万円)



経常利益・純利益

■ 経常利益 ■ 純利益

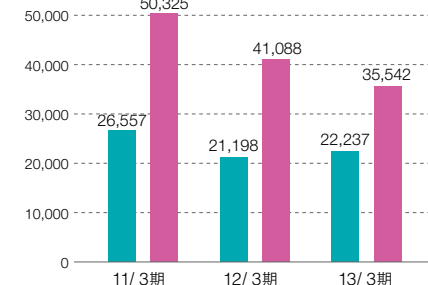
(百万円)



純資産・総資産

■ 純資産 ■ 総資産

(百万円)



業績ハイライト

当連結会計年度における当社グループの業績は、テスト受託においては主要顧客のウエハ生産数量が低迷したことなどから低調に推移いたしました。また、ウエハレベルパッケージ(WLP)受託においては、一部顧客の製品切り替えや顧客の生産調整などにより受託数量が減少し、低迷いたしました。

このような状況により、売上高は21,306百万円(前年同期比11.9%減)、営業損益は42百万円の損失(前年同期は2,709百万円の利益)、経常利益は101百万円(前年同期比95.8%減)、当期純利益は500百万円(前年同期は5,530百万円の損失)となりました。

■ メモリ事業について

メモリ事業におきましては、主にモバイル機器に使用されるテスト時間の長い製品の受託数量は増加しましたが、主にPC向けに使用されるテスト時間の短い製品は大幅に受託数量が減少しました。

これらの結果、当連結会計年度のメモリ事業の売上高は15,248百万円(前年同期比22.8%減)、セグメント利益は1,869百万円(同62.4%減)となりました。

■ システムLSI 事業について

システムLSI事業のテスト受託におきましては、イメージセンサの受託が増加するなど比較的堅調に推移いたしました。しかしながら、WLP受託では、モバイル機器向け製品の生産調整などの影響により受託数量が減少したため、稼働率が低迷し低調に推移いたしました。

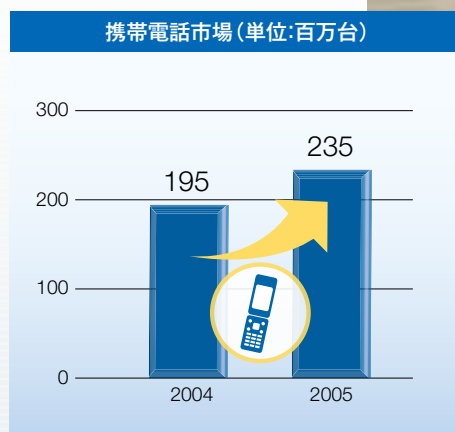
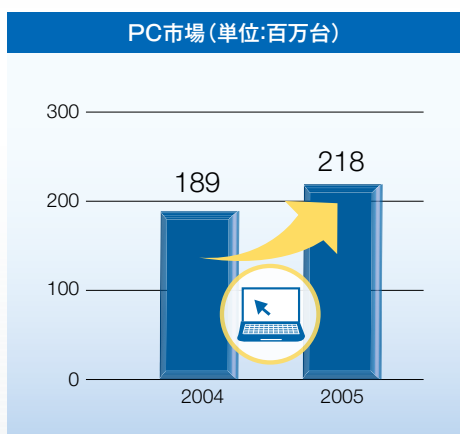
これらの結果、当連結会計年度のシステムLSI事業の売上高は6,067百万円(前年同期比34.0%増)、セグメント損益は496百万円の損失(前年同期は998百万円の損失)となりました。

TeraProbe

テストビジネスのスタート

テラプローブが設立された2005年は、OSにWindowsXPを搭載したPCが普及した時期です。それは同時にPC用DRAMに対する市場の需要が大変高かった時期でもあります。また、多機能携帯電話が世界的に普及し、全盛期を迎えつつありました。このような時代背景の中、テラプローブのウエハテストビジネスへの挑戦が始まりました。

DRAM



2005.8
会社設立



2005.10
広島工場、テスト業務開始



2006.09
九州事業所、テスト事業開始



iPhone 販売開始



DDR2-SDRAM



GDDR3



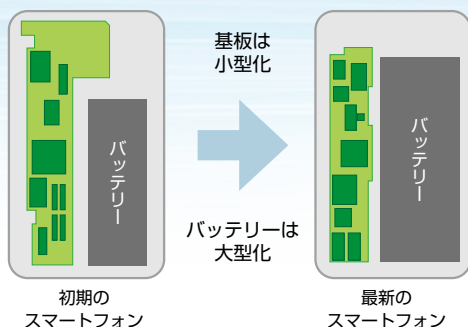
2005

2006

2007

ウエハテストからWLP工程へ

2011年10月からは東京都青梅市にある、旧カシオマイクロニクスが新たにテラミクロスとしてテラプローブグループに加わりました。今やモバイル機器に無くてはならない、WLPという小型、薄型のパッケージの提供を開始し、ウエハテスト工程に加え、パッケージ工程、ファイナルテストまでを一貫して提供できる体制を整えました。



※スマートフォン、タブレットなど携帯機器でWLPは数多く使用され、製品の小型化、バッテリーの大容量化に貢献しています。

WLP

半導体製造のバックエンド(後工程)ターンキーサービスにより、顧客の利便性を向上



バックエンドターンキーサービスとは、顧客がウエハ検査後の全ての工程を一括で委託することで、品質、納期等の管理を一元化できるサービスです。

- 2008.8 TeraPower Technology Inc.設立

- Windows 7

2008

2009

2010

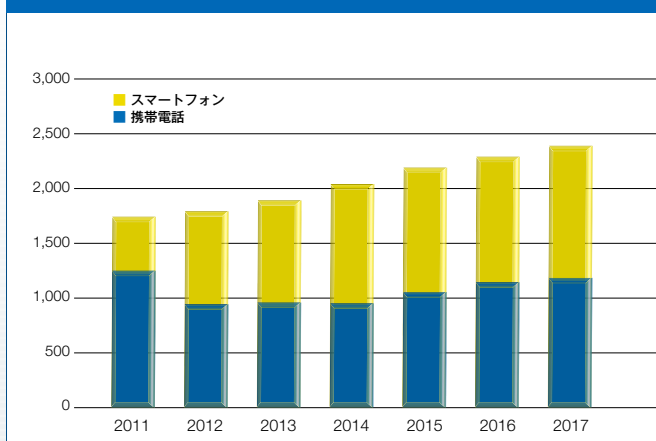
PC用DRAMからモバイルDRAM、そして次世代メモリへ

現在、当社が受託しているメモリ製品は、PC向けの汎用DRAMから、より高い性能が求められるスマートフォン、タブレット端末向けの低消費電力タイプ(モバイルDRAM)にその中心が移ってきています。スマートフォンなどモバイル機器の世界市場に目を向けると、この1、2年でスマートフォン、タブレットの普及は飛躍的に進んでおり、2013年度中にスマートフォンの販売台数が、携帯電話を追い越すと見られています。モバイル機器の進化と共に、DRAMもより高い性能が求められている中、当社はテストを通じて、この大きな流れを支えてまいります。

また多くの半導体メーカーや研究機関などにより、既存のメモリ製品を代表するDRAMとNAND Flashの長所を合わせた様々な次世代メモリの開発が現在世界中で進められています。当社もこれら次世代メモリに適したテスト技術の開発を進めております。

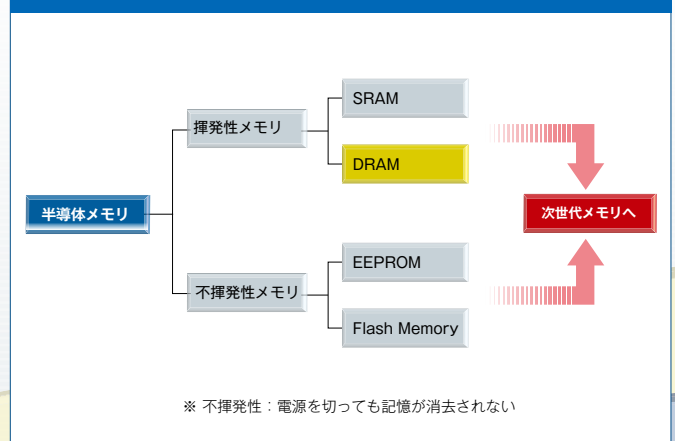


世界の携帯電話、スマートフォンの販売台数(単位:百万台)



(株)シード・プランニング「携帯電話世界市場動向調査(2012/3/21発表)」より

メモリ体系図



2005

● 2010.12.16
東証マザーズ上場

● 2011.10.1
テラミクロス事業開始

● iPad 販売開始

● LP DDR1

● LP DDR2

● DDR3-SDRAM

● GDDR5

2011

2012

2013

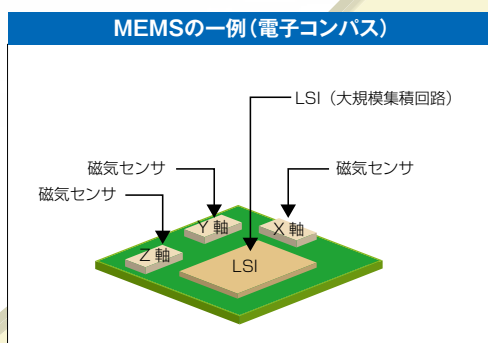
テラプローブの新しい挑戦

当社グループでは、スマートフォン市場の拡大に伴い、これに関連してメモリ以外にもイメージセンサやマイコンなどのテスト受託が増えております。今後は、このスマートフォン市場の成長をしっかりと取り込みつつ、さらに最終市場が異なる受託品の開拓も積極的に進めてまいります。

例えば、九州事業所や台湾の現地法人では、自動車向けの品質基準であるISO/TS16949という認証を取得し、車載向け半導体のテスト受託に向け準備を整えております。

また、小型・薄型という特徴からモバイル機器向けに市場が拡大しつつあるWLPについても、技術的な課題から、現在使用されているのはまだ小型の半導体製品の一部に留まっています。当社グループでは、未開拓市場であるより大きなサイズの半導体製品に対してもWLPが使用できるよう技術開発を強化し、新たな市場を育てていきたいと考えております。さらに半導体以外の、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)に対してもWLPの使用を推進してまいります。既にMEMSの1種で、微弱な地磁気を磁気センサーが検出して、方位角(磁北)を求める機能を備えた電子コンパスなどではWLPの採用が進んでおりますが、MEMSについてもWLPの使用を拡大できるものと考えております。

このようにテラプローブグループは、既存ビジネスの拡大に対応するとともに、新たな市場の獲得に挑戦してまいります。



Near Future

Smart Phone

Tablet

PC



SEMICON JAPAN 2012

2010

2015

SEMICON
JAPAN 2012

TeraProbe

Windows 8

Windows

スマホ、タブレット

● LP DDR3

モバイルDRAM

● DDR4-SDRAM

汎用DRAM

Graphics DRAM

イメージセンサー

ロジック(CPU、SoC) アナログ(RF、パワー)

2013

2014

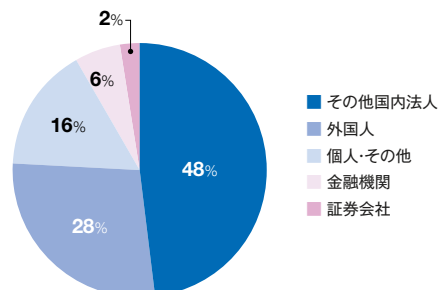
2015

株式情報

(2013年3月31日現在)

発行可能株式総数 30,000,000株
発行済株式の総数 9,282,500株
株主数 2,464名
大株主

株主名	持株数	(%)
エルピーダメモリ株式会社	3,680,000	39.64
MSIP CLIENT SECURITIES	1,129,300	12.16
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	770,200	8.29
株式会社アドバンテスト	760,000	8.18
UBS AG HONG KONG	305,800	3.29
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	218,700	2.35
日本証券金融株式会社	140,100	1.50
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	139,600	1.50
立花証券株式会社	96,300	1.03
神林忠弘	94,300	1.01



(注) 1.持株比率は自己株式(41株)を控除して計算しております。
2.持株比率は小数点第3位を切り捨てて表示しております。

株主メモ

上場証券取引所 東京証券取引所 マザーズ
事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
株式の売買単位 100株
公告方法 公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
公告掲載URL <http://www.teraprobe.com/>
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
事務取扱場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先 〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先 ☎0120-782-031
インターネット <http://www.smtb.jp/personal/agency>
ホームページURL

ホームページのご案内

当社では、株主・投資家の皆様にプレスリリースや決算説明資料などのIR情報をホームページにて公開しております。是非、ご覧ください。



株式会社テラプローブ

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-17

TEL:045-476-5711

ホームページアドレス <http://www.teraprobe.com/>